

有机硅导热填缝胶

GapSil 2600

序列号 TC 20

一、产品概述

GapSil 2600 (TC20) 是一种双组份有机硅导热填缝胶, 适用于电子电器产品的散热和减震防护。产品可以加热固化, 形成具有柔软的导热材料。

二、产品特性

1. 导热率-2W/m.K, 低比重-1.95;
2. 固化过程中收缩小;
3. 加热可快速固化;
4. 绝缘性优异, 抗老化性能好, 可在-40~200°C 内长期保持橡胶弹性;
5. 符合 ROHS/REACH, 环体含量 D3-D10<100ppm。

三、典型性能指标

序号	测试项目	单位	参考标准/条件	测试结果
1	A 组分外观	---	目测	淡黄色膏体
2	B 组分外观	---		白色膏体
3	A 组分粘度 ¹	Pa·s	GB/T 10247	77
4	B 组分粘度 ¹	Pa·s		57
5	A、B 混合比例	---	---	1:1
6	下垂度		GB/T-13477.6	<1mm
7	固化时间 ²	h	25°C	21
8	密度	g/cm ³	HG/T 2728	1.95
9	邵氏硬度	Shore 00	GB/T 531.1	55
10	拉伸强度	MPa	GB/T 528	>0.2
11	伸长率	%	GB/T 528	40~50%
12	导热系数	W/(m·K)	ISO 22007-2	2
13	体积电阻率	Ω·cm	GB/T 1692	>1×10 ¹²
14	击穿电压强度	kV/mm	GB/T 1695	>10
15	阻燃性能@1.5mm	---	UL94	V0

注: 1、采用设备型号: Anton Paar Rheometer, 测试剪切速率为 10s⁻¹;

2、操作时间和初固时间: 根据客户要求调整;

四、应用领域

广泛应用于精密电子元器件、电子模块、电器模块、照明电器、光伏逆变器、电源和线路板等的散热和减震保护。

有机硅导热填缝胶

GapSil 2600

序列号 TC 20

五、施工方法

- 1、将 A、B 两组分按质量比 1: 1 称量, 然后通过静态混合器混合均匀, 以手动或者自动方式点到应用界面上, 然后加热固化条即可;
- 2、温度偏低会导致固化速度偏慢。

六、使用注意事项

- 1、将 A 和 B 两组分混合时, 配比不准确将会影响硫化过程和制品性能, 因此要准确控制比例。
- 2、如果胶料接触某些如含氮、磷、硫、锡等化合物的物质, 则会抑制硫化反应, 严重将导致产品不硫化, 应极力避免和此类物质接触。

七、包装规格

- A/B 支装: 200/200 毫升
- A/B 桶装: 30/30 公斤

八、储存及运输

- 1、A 组分需避光、避热、密封储存 (可作为非危险品运输及储存);
- 2、低于 40°C 条件下可储存 9 个月。

九、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料, 本公司对此不承担任何义务, 同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。